

附件一、「2017 TSIA 半導體獎：博士研究生」申請表

申請編號 (由本會填寫)		申請日期 (西元年/月/日)	
-----------------	--	-------------------	--

一、個人基本資料：

學校名稱	(中文)		
	(英文)		
系所名稱	(中文)		
	(英文)		
申請人	(中文姓名)		(英文姓名)
身份證字號		生日	西元 年 月 日
戶籍地址			
通訊地址			
電話	(市話) (手機)	Email	

二、學歷狀況：(請依最高學歷往下填寫)

學位	學校	科系	修習期間 (西元年/月~西元年/月)

三、工作經歷：(若有請填寫，並依最近工作經歷往下填寫)

任職公司	部門/職位	工作內容	任職期間 (西元年/月~西元年/月)

四、參與學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟： (若欄位不足，請自行新增。)

事蹟名稱	主辦單位	時間(西元年/月/日)	概述

五、可供徵詢之專家資料

姓名	服務單位/職稱	電話(公司/手機)	Email	與申請人之關係

六、自傳(500字內)

七、自述研究成果或貢獻及其重要性(500字內)

八、學生證正反面影本

<p>學生證正面黏貼處</p>	<p>學生證反面黏貼處</p>
-----------------	-----------------

九、身份證正反面影本

<p>身份證正面黏貼處</p>	<p>身份證反面黏貼處</p>
-----------------	-----------------

十、應備文件點檢表：

項目	請打“v”	文件名稱
10-1		申請表正本(有制式表格，請向各校索取-附件一)。
10-2		推薦函正本(有制式表格，請向各校索取-附件二)。
10-3		學生證及身份證正反面影本各乙份(請貼於本申請表)。
10-4		博士班修習期間成績單正本。
10-5		參與半導體學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟之相關佐證資料。
10-6		請將 10-1~10-5 文件掃描為單一 PDF 檔案後，上傳至 goo.gl/D1a005 (檔案上限 25MB)，以利建檔。

附件二、「2017 TSIA 半導體獎：博士研究生」推薦函

一、被推薦人資料

學校		系所	
姓名		生日	西元 年 月 日
電話	(市話) (手機)	Email	
通訊地址			

二、推薦人資料

任職機構		任職部門	
姓名		職稱	
電話	(市話) (手機)	Email	
通訊地址			
與被推薦人的關係			

三、推薦理由

推薦人簽名:

日期： 年 月 日